

光チップレット/Co-Packaged Optics

- 開発中 -

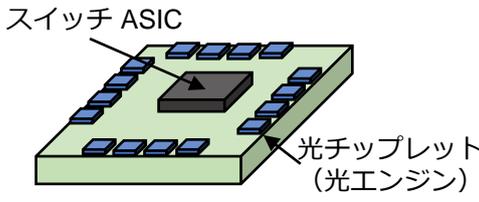
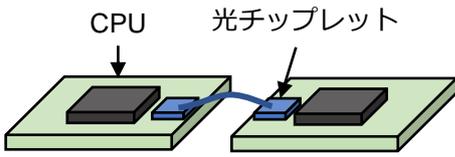
概要

- 光学デバイスとFA（ファイバーアレイ）を高効率に光学実装した光チップレット*組立
- xPU（CPU、GPU等）とパッケージ間の光通信を実現する光チップレットを実装したCo-Packaged Optics（CPO）組立

*光チップレットとは、光電変換デバイスを含む光集積回路（PIC：Photonic Integrated Circuit）と電子集積回路（EIC：Electronic Integrated Circuit）とを高密度実装した光電融合デバイス

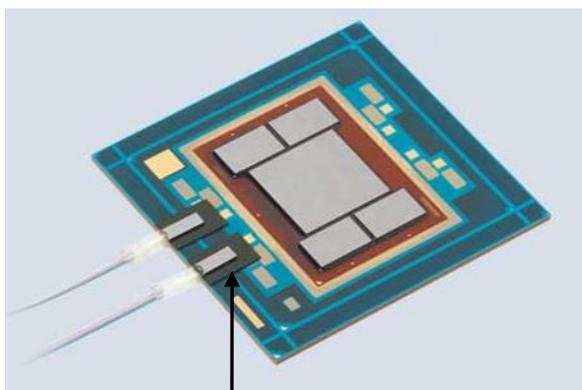
技術

- 新光電気では、光電融合の実現に向け、当社のコアテクノロジーである半導体パッケージ用基板技術、IC組立技術に加え、光学実装技術、光配線技術の開発を行っています。

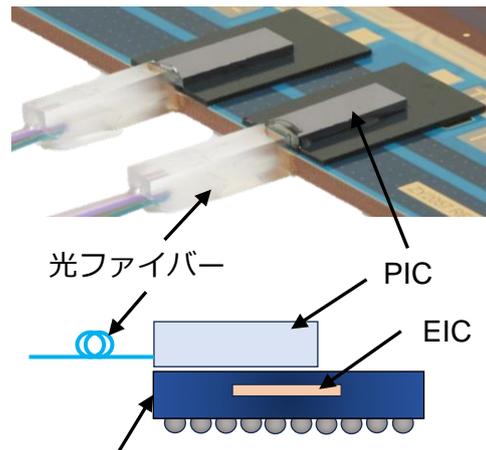
	Board to Package	Package to Package
使用事例	ネットワークスイッチ用途	サーバー用途
構造	 <p>スイッチ ASIC 光チップレット (光エンジン)</p>	 <p>CPU 光チップレット</p>
コア技術	◆実装技術 ◆アクティブアライメント技術 ◆薄型・高密度配線基板技術	

構造

- 半導体パッケージ端に小型光チップレットによる光インターフェイスを配置



光チップレット



EIC内蔵半導体パッケージ

光チップレット構造

新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町80

お問い合わせは当社Webサイトからお願いいたします。

<https://www.shinko.co.jp/product/inquiry/form/index.php>



SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.

80 Oshimada-machi, Nagano-shi, Nagano 381-2287 JAPAN

Please contact us via inquiry form on the web.

<https://www.shinko.co.jp/english/product/inquiry/form/index.php>

